

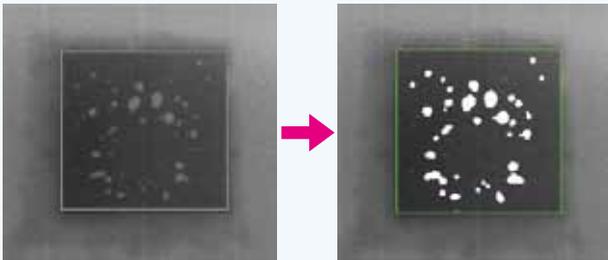
先進のX線技術実装検査の未来を拓く

パワーデバイス用 X線自動検査装置

IX-500z



パワーデバイスのボイド率自動検査



プログラマブルで自動測定可能

パワーデバイスの自動検査プログラム

概要

Summary

パワーデバイス(IGBTなど)のチップ下のボイド(気泡)率、はんだ量などを自動で検査するX線検査装置です。品種別、製造ロット毎のボイド率管理を定量的に行うことができます。

高出力マイクロフォーカスX線管によって銅板T=6mm程度のヒートシンク付き部品でも検査可能です。また145万画素X線イメージ・インテンシファイアとの組み合わせで高解像度X線画像を取得できます。

特徴

Feature

1. 自動検査アルゴリズムによるボイド率、はんだ量の自動検査
2. コンパクトな筐体
3. 150kV、75Wの高出力マイクロフォーカスX線を採用
4. 145万画素、4096階調X線イメージ・インテンシファイヤ(LI)による高解像度X線画像の取得

